

成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目 - 中标结果公告

项目名称：成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目

项目编号：4197-2240CDGT0001/27

招标范围：X-ray检测设备

招标机构：中电商务（北京）有限公司

招标人：成都高投芯未半导体有限公司

开标时间：2023-04-25 10:00

公示时间：2023-04-27 10:58 - 2023-05-05 23:59

中标结果公告时间：2023-05-06 16:04

中标人：昆山松航电子科技有限公司

制造商：日联科技

制造商国家或地区：中国

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 赵桢 （签名）

招标人或其招标代理机构：  （盖章）